

Ottobrunn, 30.06.2006

Ansprechpartner für diese Pressemeldung

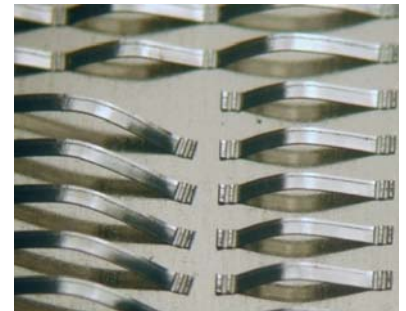
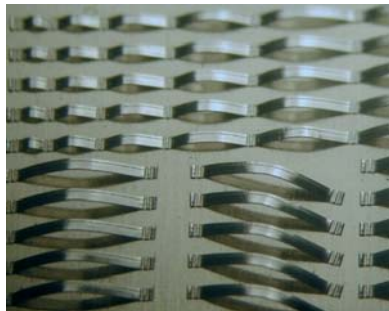
Philip Homami, Sales Manager Europe
Email: Philip.Homami@de.fkdelvotec.com
Tel.: +49 89-62995-146

Dr. Josef Sedlmair, Sales Coordination International
Email: Josef.Sedlmair@de.fkdelvotec.com
Tel.: +49-89-62995-142

F&K Delvotec stellt Dickdraht-Bändchenbonden vor

Während der SMT/Hybrid/Packaging 2006 in Nürnberg präsentierte F&K Delvotec erstmals den Heavy-Ribbon Bonder 66000 G5. Die spezielle Variante des erfolgreichen Dickdrahtbonders ist durch einfache Umrüstung in der Lage, mit Aluminium-Bändchen für Leistungsanwendungen zu bonden.

Diese Technologie wird in den letzten Jahren für zahlreiche Power-Anwendungen immer populärer, denn sie bietet gleichzeitig höhere Stromtragfähigkeit auf geringerer Kontaktfläche und höhere Bond-Produktivität. Dabei bleibt der Bondprozess unverändert robust und zuverlässig, und die patentierte Bondprozesskontrolle BPC kann wie gewohnt zur Prozessverbesserung eingesetzt werden.



F&K Delvotec ist ein führender Anbieter von Bondsystemen mit weltweitem Kundenstamm. Zu den Kunden gehören Halbleiterhersteller und Firmen aus allen Bereichen der Mikroelektronikindustrie.

F&K Delvotec hat es sich zum Ziel gesetzt, der Industrie erstklassige Bondprozesse basierend auf neuesten Bondsystemen zu liefern und hervorragenden Kundendienst und Applikationsunterstützung zu bieten.

F&K Delvotec bietet die größte Auswahl an Diebondern, Drahtbondern und Bondtestsystemen für die Herstellung von diskreten Bauteilen, ICs, Hybrid-Systemen und Sensoren, sowie Multi-Chip Modulen (MCM), Chip-on-Board (COB) Anwendungen und MEMCs auf dem Markt. Kunden von F&K Delvotec sind in folgenden Bereichen tätig: Halbleiterindustrie, Hochleistungskomponenten, Medizintechnologie, Automobil- und Transportindustrie, Photonics und Laser, Computer und Peripherie, Tele- und Datenkommunikation, industrielle Anwendungen, Sensoren, Militär & Verteidigung, Luft- und Raumfahrtanwendungen.

www.fkdelvotec.com